

BGA (FCCSP)

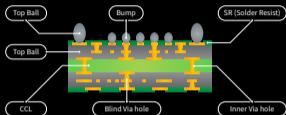
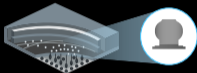
개요

OVERVIEW

범프를 통해 반도체와 메인보드를 연결하는 패키지 기판

- 전기적 신호의 이동 경로가 짧고, 많은 수의 I/O 형성 가능
- 응용 분야: AP (Application Processor), Modem 등

[FCCSP]



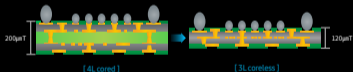
차별화

DIFFERENTIATION

박형 & 미세 회로 개발

- Fine Pitch Coreless 기판

- 회로 패턴이 절연재 안에 묻혀있는 형태의 회로 기판
- Coreless + 미세회로 형성으로 Layer 축소 설계 용이 (4L→3L)



주요 사양

KEY SPECIFICATIONS

회로 (Line/Space)	8/10µm
Peripheral Bump Pitch	35µm
Bump Pitch	125µm
Core/PPG 두께	40µm/18µm